

证券代码：688079

公司简称：美迪凯

杭州美迪凯光电科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系 活动类别	业绩说明会
活动主题	美迪凯 2025 年第三季度业绩说明会
时间	2025-11-12 - 09:00-10:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
参会人员	董事长兼总经理：葛文志、副总经理兼董事会秘书：王懿伟、副 总经理兼财务总监：华朝花、独立董事：裘益政
投资者关系 活动主要内 容介绍	Q1：近两年来，公司营业收入实现了比较大的增长，但利润亏损依 然，同时研发投入也较多，效果不明显。请问，何时能够实现营业 收入与利润同增长，研发成果体现在利润上？ 答：尊敬的投资者，您好！ 公司 2025 年前三季度营收同比增长 32.04%，主要为半导体声光学、半导体封测等新产品放量交付影响。 但由于新产品仍处于产能爬坡期，固定成本较高，同时公司为构建 长期竞争力持续加大研发投入等原因，导致短期利润承压。2025 前 三季度实现 EBITDA（息税折旧摊销前利润）8,079 万元左右。 目前研发成果已逐步显现，超声波指纹识别芯片声学层、图像 传感器光路层、半导体制程胶合棱镜等产品已实现批量交付， MicroLED 已开始小批量生产和交付，非制冷红外芯片等已开始送样 并得到客户认可，通过收购整合成功切入三星的客户供应链。公司 现阶段研发内容主要包括：新一代半导体工艺键合棱镜、多通道色 谱芯片光路层产品、超透镜（Metalens）、WLCSP 封装、射频滤波器 BAW 等。随着新开发产品的逐步量产、规模化效应释放及产能利用 率提升，公司盈利能力将逐步提升，届时研发投入将持续转化为盈 利动能，为投资者创造长期价值。感谢您的关注！ Q2：请问葛董事长：投资美迪凯公司至今连续亏损 2 年，请问 2026 年会有盈利希望吗？要给中小散户吃颗定心丸，谢谢！ 答：尊敬的投资者，您好！ 目前公司正处于从技术投入期向规模收 获期过渡的关键阶段，虽然近年因新产线建设、研发投入及产能爬

坡等因素导致阶段性亏损，但随着半导体声光学、晶圆级封装等核心产品持续放量，产能利用率逐步提升，产品结构不断优化，归上市公司股东净利润有望逐渐向好。我们将全力以赴推动技术成果转化与经营效率提升，以实实在在的业绩回报广大投资者的支持与信任。感谢您的关注与支持！

Q3: 请问，公司杭州新厂什么时候可以开工啊，新厂设计产能是老厂产能的几倍，请葛总详细聊聊？

答:尊敬的投资者，您好！感谢您对美迪凯杭州新厂的关注。截至目前，新厂区的建筑工程已于 2025 年 6 月完成规划验收，项目正按计划有序推进中。关于公司各基地的具体产能情况，敬请关注公司后续发布的定期报告或相关公告。感谢您的关注与支持！

Q4: 您好！问董秘，市场总共 5400 多家上市公司，公司市场人气排名，常年倒数 5300 多名，想请教关于公司投资者关系管理的问题：注意到公司在沪深互动平台的活跃度及机构调研频次相对较少，当前市场环境下，广大中小投资者与专业机构对上市公司的日常沟通及信息透明度愈发重视。想请教管理层：公司在完善投资者交流机制、提升信息披露质量与透明度方面是否有系统性规划？未来是否会主动加强与各类投资者的沟通频次与深度，比如定期举办业绩说明会、增加投资者接待及路演活动？是否有考虑设定具体的投资者关系工作考核指标（如年度调研次数、互动平台回复时效性等）来持续提升沟通效率与市场关注度？

答:尊敬的投资者，您好！衷心感谢您的宝贵建议。公司高度重视投资者关系管理，已将其纳入系统化、常态化的工作规划。我们将常态化举办定期报告业绩说明会，由公司核心管理层亲自出席，深度解读业绩。同时，有计划地增加机构投资者线下路演与“投资者接待日”频次，加强与各类投资者的深度交流。我们承诺提升 e 互动平台的回复速度与质量，以提升沟通效能。公司将持续优化信息披露，以更开放、高效的态度构建与市场的互信关系。敬请关注公司法定披露公告。感谢您的关注与支持！

Q5: 公司 2025 年第四季度及 2026 年的业绩展望如何？

答:尊敬的投资者，您好！目前，公司半导体声光学、半导体封测等核心产品产销稳步提升，产能利用率持续优化。展望未来，半导体工艺键合棱镜等新产品的产能释放、Micro LED 技术的量产推进，以及与三星等国际客户的合作深化，将持续驱动公司业务发展。公司相信，伴随研发成果的有效转化与规模效应的逐步显现，将有望为未来业绩带来积极影响。具体的业绩情况也请您持续关注，以后续披露的定期报告为准。感谢您的关注和支持！

Q6: 公司此前提及半导体声光学、封测业务快速增长，MicroLED 等新产品将带来增长动力，且 12 英寸 90nm 节点 KrF 光刻机已入驻，

请问目前这些新业务、新产品的市场拓展进度如何？

答:尊敬的投资者,您好!目前,超声波指纹芯片整套声学层及后道封测工艺、图像传感器(CIS)光路层解决方案、半导体工艺键合棱镜等已实现量产;Micro LED项目与多家客户紧密合作,已小批量交付;同时也在加速海外市场封测业务的拓展。感谢您对公司的关注与支持!

Q7: 公司最近收购了两家子公司,目前的整合进展如何?是否已产生协同效应?

答:尊敬的投资者,您好!公司对海硕力与越南子公司的收购整合已顺利完成,协同效应正逐步显现。目前,两家子公司正处于持续爬坡放量阶段,盈利能力稳步提升。通过日本、韩国子公司及越南生产基地的协同布局,公司进一步整合了海内外产能与客户资源,优化了全球产业链配置。感谢您的关注与支持!

Q8: 公司未来业务重心将会如何分配?

答:尊敬的投资者,您好!公司专注于半导体声学/光学、半导体微纳电路(以MEMS为主)、半导体封测、精密光学、微纳光学及智慧终端等领域的研发、制造与销售。当前,公司的业务重心聚焦于以下方面:

- 1、随着人形机器人及AI等领域的快速发展,MEMS传感器的需求日益增加,公司将持续加大MEMS传感器相关产品的研发投入与产能布局。
- 2、半导体与光学相结合的创新业务,是公司长期坚持的核心发展方向之一。
- 3、公司坚定执行“国内深耕”与“海外拓展”并举的战略。通过收购越南工厂、设立韩国子公司,并与现有日本子公司协同联动,持续完善全球化产业布局。感谢您的关注与支持!

Q9: 公司在半年报中提到在开发中的棱镜、Micro LED等项目进展如何?何时能实现量产?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您对公司新项目进展的持续关注。目前,多项在研新技术已取得显著突破并正有序迈向产业化:

其中,半导体工艺键合棱镜首次在安卓手机中被采用,通过半导体制程,可精准控制低反低透膜尺寸精度,并通过特殊图形化设计加工,有效规避传统开槽棱镜粗糙界面导致的炫光和对对比度下降的难题,具备优异的杂散光抑制效果。并且通过简化结构、减少有害反射界面,在光效、像质纯净度和稳定性上具备优势;

Micro LED项目与多家客户紧密合作,已小批量交付;

非制冷红外传感器也已成功突破全流程技术瓶颈,在向客户送样后获得了积极反馈。

这些项目的顺利推进,充分体现了公司的创新动能与技术储备,

	将为公司未来成长注入强劲动力。感谢您的关注和支持！ Q10：公司经营活动现金流净额从 2025 年半年报时的同比增长 55.7%，到 2025 年三季报同比大增 107.45%，是何原因？ 答:尊敬的投资者，您好！公司现金流显著改善主要是公司核心产品竞争力凸显，销售商品收到的现金增加。感谢您的关注与支持！ Q11：上市公司是否计划进行市值管理？ 答:尊敬的投资者，您好！公司始终高度重视市值维护，将在专注主业持续推动经营业绩提升的同时，规范运作、提升信息披露质量，并积极通过业绩说明会、接待投资者机构调研等方式维护投资者关系，增进市场对公司价值的了解和认可，力争为广大投资者带来良好回报。感谢您的关注与支持！
附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 11 月 12 日